

For 5G Communication

Scrum-LCP FILM

ひたすら
開発中
Under development

新規開発中の液晶ポリマー（LCP）フィルムです

高周波、高速伝送に適した低誘電特性をもつ
伝送損失の低いフィルム材料です

物性値（General properties）

	Scrum-LCP FILM
フィルム厚さ Film thickness	50～100μm
誘電率 Dielectric constant (10GHz)	3.4
誘電正接 Dissipation factor (10GHz)	0.0015
熱膨張係数 (CTE) Coefficient of thermal expansion	16.0ppm/degree C
引張強度 Tensile strength	110MPa
引張伸度 Tensile elongation	13.0%
ヤング率 Young's modulus	4.0GPa
吸水率 Water absorption	0.01%

*本データは代表値であり、保証値ではありません

SCRUM

有限会社スクラム
www.scrumjapan.co.jp



ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.

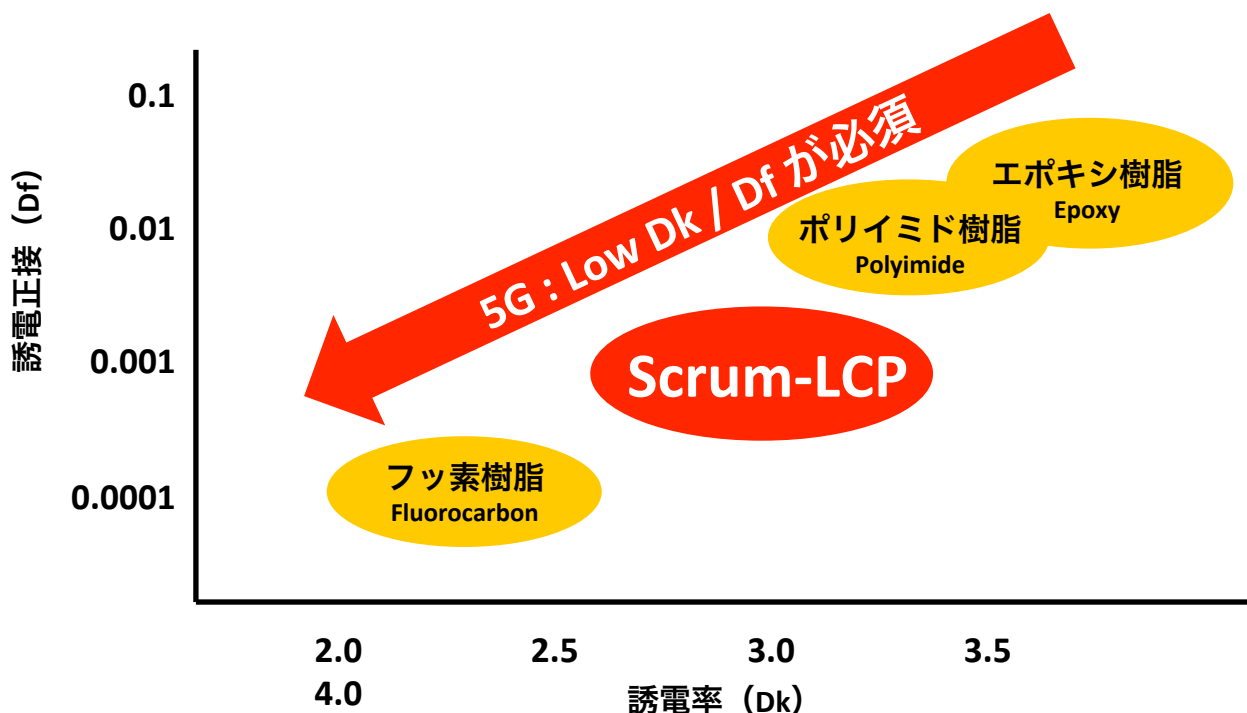
For 5G Communication

Scrum-LCP FILM

ひたすら
開発中

Under development

誘電率・誘電正接 (Dielectric constant • Dissipation factor)



フィルムの特徴比較 (Characteristic comparison)

	LCP	ポリイミド Polyimide	フッ素樹脂 Fluorocarbon
耐熱性 Heat resistance	◎	◎	◎
熱膨張係数 CTE	◎	◎	×
誘電特性 Dissipation factor	○	△	◎
吸水率 Water absorption	◎	×	◎
価格 Cost	○	◎	×

SCRUM

有限会社スクラム
www.scrumjapan.co.jp



ONE FOR ALL, ALL FOR ONE.